

# 【レーザーJOB株式会社】

## 高輝度ファイバーレーザーによる微細加工の多様化及び高速化の開発

### 開発のねらい

レーザー加工技術により新たな産業分野（パワー半導体、メディカル）に参入するために『高速化』と『3次元』に取り組む。

### 開発の概要

高輝度ファイバーレーザーを使用して下記加工技術を開発する。

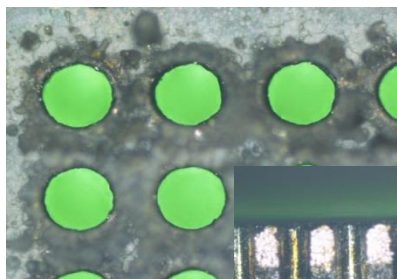
- ①微細穴あけ加工の高速化（パワー半導体-量産穴あけツールの可能性）
- ②3次元加工（メディカル『ステント』の基礎技術の習得）

### 特長

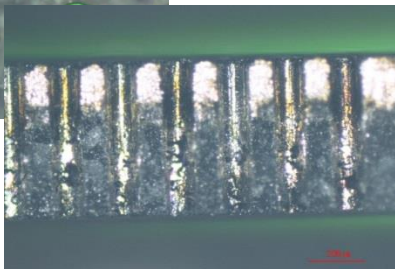
- ①ファイバーレーザーによる加工エネルギー密度が非常に高い加工ができる
- ②加工光学系を2系統切り替えができる  
（ガルバノスキャナ光学系、固定光学系w/同軸アシストエア）
- ③独立した回転軸ステージにより任意の3次元加工ができる

### 用途

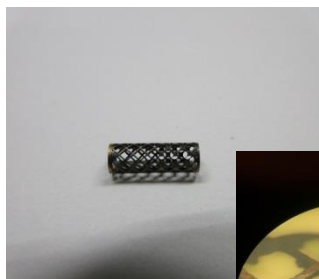
パワー半導体：放熱部材（材料：窒化アルミ）  
メディカル：カテーテル、ステント



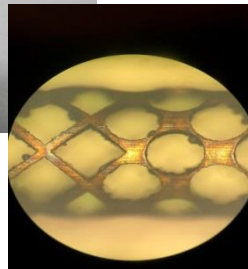
穴径  
Φ 0.1mm



窒化アルミ 高速穴あけ加工



パイプ径  
Φ3mm



susパイプ 3次元加工



2軸加工システム

### お問い合わせ先

【所在地】 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木1224-4

【連絡先】 TEL 048-422-4170 FAX 048-422-4175 開発G 大江  
<http://www.laserjobco.jp/>

